股票简称：芯碁微装　　股票代码：688630

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书

Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co.,Ltd.

合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期F3楼11层

保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

上海市黄浦区广东路689号
2021年3月31日

特别提示

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“芯碁微装”、“发行人”、“公司”、“本公司”）股票将于2021年4月1日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节　重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为20%，首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。

（二）流通股数量较少的风险

上市初期，原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，网下限售股锁定期为6个月。本公司发行后总股本为12,080.00万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为2,455.5071万股，占本次发行后总股本的比例为20.33%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率处于较高水平的风险

公司所处行业属于“专用设备制造业（C35）”，截至2021年3月18日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为50.07倍。公司本次发行市盈率为：

1、29.82倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、28.97倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、39.76倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、38.63倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

公司本次发行后摊薄的市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。未来可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

（一）产品结构及主要应用领域单一的风险

报告期内，公司主要营业收入来源为PCB直接成像设备的销售。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司PCB直接成像设备的销售收入分别为1,823.41万元、5,247.11万元、19,242.85万元和6,550.75万元，占各期主营业务收入的比例分别为82.21%、60.11%、95.14%和87.17%，产品结构较为单一；此外，发行人的PCB直接成像设备目前主要应用在PCB产品曝光工艺领域，产品应用领域较为集中。因此，公司现阶段存在产品结构及主要应用领域较为单一的风险。

（二）泛半导体直写光刻设备市场拓展及技术发展的风险

掩膜光刻和直写光刻均为泛半导体领域的光刻技术。在泛半导体各细分领域中，除掩膜版制版外，与掩膜光刻相比较，目前直写光刻在IC前道制造领域存在光刻精度及产能效率较低、在FPD制造领域存在产能效率较低等问题，总体而言，直写光刻在泛半导体领域的应用领域相对较窄，业务体量较小，是掩膜光刻的补充。在泛半导体领域，发行人直写光刻设备目前主要应用在该领域中的FPD低世代线的制造、中低端IC掩膜版制版及IC前道制造中的小批量、多批次的器件研发试制领域，未来存在一定的市场拓展风险。

此外，在泛半导体领域，直写光刻根据辐射源的不同大致可进一步分为激光直写光刻与带电粒子直写光刻，发行人直写光刻技术为激光直写光刻，尚未涉及带电粒子直写光刻。相比激光直写光刻，带电粒子直写光刻精度更高，但产能效率低，设备昂贵，对使用环境要求较高，该项技术目前主要应用在高端IC掩膜版制版领域，应用领域较为狭窄。如果未来带电粒子直写光刻技术出现较大发展，能够克服产能效率低、设备成本高等弱点，将对公司激光直写光刻设备在泛半导体领域的市场销售造成一定的技术发展风险。

（三）公司泛半导体直写光刻设备销售收入存在不确定性风险

在泛半导体领域，目前IC及FPD大规模产业化制造所用的光刻设备主要为掩膜光刻设备。报告期内，在IC领域，公司直写光刻设备客户主要为高校及科研院所微电子相关领域，其市场需求与科研项目经费具有较高的关联度，存在较大的不确定性；在FPD领域，公司直写光刻设备目前仅应用于OLED厂商低世代产线中的小批量、多批次产品的生产以及新产品的研发试制，在OLED光刻工艺环节中是掩膜光刻设备的补充，应用领域较为狭窄，与下游OLED厂商的研发产线规划、固定资产投资具有较强的关联度，从而造成公司的OLED直写光刻设备的销售收入存在较大的不确定性。

报告期内，公司泛半导体直写光刻设备的收入分别为41.03万元、3,283.42万元、209.67万元和546.55万元，占主营业务收入比例分别为1.85%、37.61%、1.04%和7.27%，具有较大的波动性，且OLED直写光刻设备仅于2018年实现一套自动线系统LDW-D1并实现2,991.45万元销售收入，占当期公司泛半导体直写光刻设备销售收入的比例为91.11%。

如果未来我国高校、研究院所的科研项目较少以及下游OLED厂商的研发、生产产线规划数量减少，将对公司的泛半导体直写光刻设备市场需求造成不利影响，从而产生泛半导体直写光刻设备销售收入不确定性风险。

（四）因市场应用及技术升级导致的产品迭代风险

PCB及泛半导体行业产品更新换代速度快，持续研发新产品是公司在市场中保持竞争优势的重要手段。公司根据市场需求变动和工艺水平发展对现有产品进行升级迭代，产品的迭代周期一般约为2年，以保持产品竞争力。公司2019年设备销售收入中，2017年以来面市的产品销售贡献为77.40%。

公司产品从导入客户到大批量出货，通常需要1-2年左右时间，并可保持平均约2-3年的销售期。未来如果公司不能及时准确地把握市场需求和技术趋势，无法保持较快的产品更迭周期，并持续推出具有竞争力的新产品以满足市场新需求，则将无法维持新老产品的滚动轮替及收入的持续增长，并对经营业绩带来不利影响。

（五）与同行业国际厂商相比，公司的产品技术水平和业务规模还存在较大差距的风险

在技术水平方面，发行人PCB直接成像设备部分核心技术指标与以色列Orbotech、日本ORC、日本ADTEC等国际厂商还存在差距；发行人泛半导体直写光刻设备核心技术指标与全球领先企业瑞典Mycronic等国际厂商还存在较大差距，因此发行人在市场竞争中面临一定的技术水平风险。

在业务规模方面，发行人成立时间较短，与上述同行业国际厂商相比较，在产品体系、销售收入规模、雇员数量、项目经验、技术积累等方面还存在较为明显的差距，从而使得发行人在市场竞争中面临业务规模风险。

（六）主要产品售价波动的风险

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，发行人主要产品PCB直接成像设备的平均销售单价分别为227.93万元/台、276.16万元/台、229.73万元/台和257.13万元/台，存在一定的波动，主要系新产品推出导致的产品结构改变以及部分客户定制化采购的结果。如果未来主要产品的销售价格继续波动甚至下降，将会对公司业绩造成不利影响。

（七）知识产权争议风险

PCB直接成像设备及泛半导体直写光刻设备行业是典型的技术密集型行业，为了保持技术优势和竞争力，防止技术外泄，已掌握先进技术的设备制造企业通常会通过申请专利等方式设置较高的进入壁垒。

2017年4月、9月，合肥芯硕以侵害其专利权为由分别对公司核心技术人员方林、何少锋提起诉讼，安徽省合肥市中级人民法院均判决驳回合肥芯硕的诉讼请求。2018年5月，合肥芯硕以侵害其专利权为由对公司提起诉讼，安徽省合肥市中级人民法院判决驳回合肥芯硕的诉讼请求，2019年1月，合肥芯硕提起上诉，安徽省高级人民法院终审判决驳回合肥芯硕的诉讼请求。上述专利纠纷未对公司的生产经营产生不利影响。

报告期内，公司加强了知识产权的管理和风险控制，除上述已决诉讼外，公司不存在其他专利侵权纠纷或诉讼情况，但公司不能排除其他竞争对手继续提出知识产权纠纷的可能。如果未来公司与竞争对手发生知识产权纠纷，在法院正式判决前，将对公司品牌形象产生一定影响；如果法院认定公司侵权，将对公司的生产经营产生不利影响。

（八）公司业绩波动的风险

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司营业收入分别为2,218.04万元、8,729.53万元、20,226.12万元和7,590.22万元，净利润分别为-684.67万元、1,729.27万元、4,762.51万元和991.31万元。报告期内，公司由于有效开发客户以及不断推出被客户认可的新产品（包含升级迭代的产品），使得业务规模逐年扩大，净利润由负转正，并呈现增长趋势，公司研发、生产、市场开拓等能力进一步快速提升。若未来发生公司新产品研发失败、不能有效拓展国内外新客户等情形，将使公司面临一定的经营压力，存在业绩波动的风险。

（九）毛利率波动的风险

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司综合毛利率分别为37.05%、58.78%、51.22%和48.59%，存在一定的波动，综合毛利率的波动主要由于产品不断推出（包括更新迭代）带来的产品结构的变化和客户定制化的需求带来的产品平均销售价格的波动。若未来市场竞争加剧、新产品开发失败等因素导致产品价格下降或产品结构发生重大不利变动，均会引起公司毛利率波动。

（十）收入季节性波动风险

报告期内，公司主营业务收入呈现一定的季节性特征，第四季度收入占比较高，主要是由于从接受订到验收的周期较长所致。下游客户通常上半年做出全年的资本性支出计划并向公司下达订单，公司接到订单后组织生产，经1-3个月生产、安装、检测等环节后再交付产品，公司生产完成后发货至客户现场，经1-3个月安装、调试并经客户验收后确认收入，下游客户通常于下半年验收设备，使得公司第四季度收入占比较高。2017年度、2018年度和2019年度，第四季度主营业务收入合计占比分别为81.51%、67.08%和55.71%。2017年度，发行人仍属初创期，产品品类较为单一且销售需要经历艰难的客户验证过程，2017年6月起，Tripod 100产品继续通过试用或试用转销售的方式推广至部分行业标杆客户处使用，发行人设备的验收周期通常为1-3个月，导致2017年第四季度验收设备较多，营业收入集中确认于第四季度，随着发行人收入规模的扩大，第四季度主营业务收入占比呈现下降趋势。主营业务收入季节性波动将增加公司执行生产计划、资金使用等运营难度，进而可能造成一定不利影响。

（十一）核心组件、核心零部件存在依赖单个或少数供应商的风险

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司核心组件、核心零部件紫外半导体激光器、激光光源和DMD集成块采购金额分别为1,386.69万元、1,477.41万元、4,345.56万元和3,678.59万元，占各期采购额的比例分别为32.14%、28.06%、26.12%和28.86%。公司上述紫外半导体激光器、激光光源和DMD集成块等核心组件、核心零部件主要向Nichia Corporation（日本）、Texas Instruments（美国）或其代理商等境外供应商采购，并导致了供应商集中度较高的情况。如果日本、美国等国贸易政策发生变化，核心组件、核心零部件无法及时供货或者替代材料不能满足要求，将对公司的生产经营和业绩造成不利影响。

（十二）存货跌价的风险

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司存货分别为5,107.41万元、6,701.47万元、13,045.39万元和21,249.08万元，占各期末流动资产的比例分别为63.76%、43.98%、29.64%和45.46%。公司存货中的发出商品主要包括已发货尚未验收的产品以及在客户处试用的产品（签署试用合同，尚未签署销售合同），其中在客户处试用的产品金额占各期发出商品的比例分别为22.16%、13.71%、55.64%和31.41%，占比较高。如果未来已发货尚未验收的设备产品未能通过客户验收，在客户处试用的产品未能最终签署正式销售合同，均可能导致发出商品退回，进而导致公司不能实现产品销售收入，并可能因客户对设备的不当使用或自然损耗导致可变现净值低于账面净值，需要计提存货跌价准备，从而影响公司的盈利水平。

（十三）经营性现金流净额与净利润金额差异较大的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,717.21万元、182.14万元、-1,587.63万元和-8,872.02万元，净利润分别为-684.67万元、1,729.27万元、4,762.51万元和991.31万元，经营活动产生的现金流量净额小于净利润。报告期内，经营活动产生的现金流量净额小于净利润，主要原因为：①公司在手订单持续增加，为了应对后续销售规模的快速增长，采购了较多的原材料，导致购买商品、接受劳务支付的现金较多；②公司第四季度确认的收入占比较高，各期末处于信用期的应收账款余额增加较多。

随着公司经营规模不断扩大，研发投入不断增长，营运资金需求日益增加，公司经营活动现金流量净额仍有可能持续低于净利润并可能导致公司出现流动性风险。

（十四）原材料价格波动对发行人生产经营影响较大的风险

报告期内，公司直接材料分别为1,024.57万元、2,922.91万元、8,582.12万元和3,450.94万元，占各期主营业务成本的比例分别为73.37%、81.22%、86.98%和88.85%，为主营业务成本的主要构成部分。

报告期内，公司产品所耗用的原材料种类及数量繁多，不同种物料由于制造工艺、用途等不同单价有较大差异，同种物料下的不同型号也存在单价上的差异。报告期内各年度各类产品销售数量、产品特点和结构影响原材料采购种类和数量，进而影响产品材料成本和主营业务成本。以2019年为例，假设其他条件不变，若原材料价格分别上升1%、5%和10%，公司毛利率分别下降0.42个百分点、2.12个百分点和4.24个百分点，净利润分别下降1.53%、7.66%和15.32%。因此，公司生产经营面临原材料价格波动带来的变动风险。

第二节　股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年2月1日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕350号《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。

具体内容如下：

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

经上海证券交易所自律监管决定书（【2021】135号）批准，本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司A股股本为12,080.00万股（每股面值1.00元），其中2,455.5071万股股票将于2021年4月1日起上市交易。证券简称为“芯碁微装”，证券代码为“688630”。

二、股票上市的相关信息

（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

（二）上市时间：2021年4月1日

（三）股票简称：芯碁微装，扩位简称：芯碁微装

（四）股票代码：688630

（五）本次公开发行后的总股本：12,080.00万股

（六）本次公开发行的股票数量：3,020.2448万股

（七）发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：2,455.5071万股

（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：9,624.4929万股

（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：453.0366万股

（十一）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节　重要承诺事项”

（十二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节　重要承诺事项”

（十三）本次上市股份的其他限售安排：1、网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。根据摇号结果，参与网下配售摇号的共有3,298个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为330个。所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,117,011股，占网下发行总量的7.25%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.35%，占本次发行股票总量的3.70%。2、战略配售部分，海通创新证券投资有限公司获配1,510,122股，占本次发行股票总量的5.00%，获配股票限售期为24个月；海通资管汇享芯碁微装员工战略配售集合资产管理计划获配3,020,244股，占本次发行股票总量的10.00%，获配股票的限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十五）上市保荐机构：海通证券股份有限公司

三、上市标准

公司股票上市符合《中华人民共和国证券法》和《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件：

1、发行后股本总额为人民币12,080.00万元，不低于人民币3,000.00万元；

2、本次公开发行股份总数为3,020.2448万股，占发行后股份总数的25.00%，不低于发行人发行后股份总数的25.00%；

3、市值及财务指标本次发行价格确定后发行人上市时市值为18.40亿元，2018年、2019年扣除非经常性损益前后孰低的净利润为1,727.38万元、4,627.00万元，最近一年营业收入为20,226.12万元，满足招股说明书（申报稿）中明确选择的市值与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）款的上市标准：

“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。

第三节　发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人概况

发行人	合肥芯碁微电子装备股份有限公司
英文名称	Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co.,Ltd
本次发行前注册资本	9,059.7552万元
法定代表人	程卓
有限公司成立日期	2015年6月30日
整体变更为股份公司日期	2019年10月23日
住所	合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期F3楼11层
主要生产经营地址	合肥市高新区创新大道2800号合肥创新产业园二期G区4幢102
经营范围	集成电路、印刷电路、平板显示、平板印刷、新能源工业领域的高端制造装备及软硬件产品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	主要从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备的研发、制造、销售以及相应的维保服务，主要产品及服务包括PCB直接成像设备及自动线系统、泛半导体直写光刻设备及自动线系统、其他激光直接成像设备以及上述产品的售后维保服务，产品功能涵盖微米到纳米的多领域光刻环节。
所属行业	C35专用设备制造业
电话	0551-63826207
邮政编码	230088
传真	-
互联网网址	http://www.cfmee.cn/
电子信箱	yzwei@cfmee.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
负责信息披露和投资者关系负责人	魏永珍（董事会秘书）
负责信息披露和投资者关系电话	0551-63826207

二、发行人控股股东、实际控制人情况

（一）发行人控股股东、实际控制人基本情况

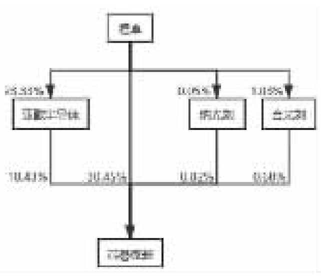
公司的控股股东、实际控制人为程卓。

本次发行前，程卓直接持有公司股份比例为40.61%，为公司的控股股东。同时，程卓通过亚歌半导体控制公司13.91%的股份，通过纳光刻控制公司1.10%的股份，通过合光刻控制公司0.91%的股份。程卓直接及间接控制公司股份合计为56.53%，为公司实际控制人，基本情况如下：

程卓，女，1966年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，身份证号码为34242519660521XXXX。程卓于1981年9月至1984年6月就读于安徽省大江技校机械专业，1982年9月至1985年8月就读于安徽电大汉语言文学专业，1984年8月至1998年4月，在国营九四〇九厂（安徽通用机械厂）从事管理工作；1998年12月至2012年12月，担任安徽盛佳拍卖有限责任公司总经理；2002年5月至2005年1月就读于安徽工商管理学院工商管理专业；2011年7月至2019年10月，担任安徽盛佳奔富商贸有限责任公司法定代表人、执行董事；2016年3月至2019年10月，担任芯碁有限董事长；2019年10月至今，担任发行人董事长。除上述主要工作经历外，程卓于2015年4月-6月，因参与合肥芯硕重整事宜，被合肥芯硕股东会选为董事长、财务总监（董事长一职未签署聘任协议、未办理工商变更，财务总监一职未签署劳动合同，未领取薪酬）。

（二）本次发行后与实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后，发行人与实际控制人的股权结构控制关系图如下：



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

截至目前，发行人董事会由9名董事组成，其中独立董事3人；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人；高级管理人员2人；核心技术人员3人。具体情况如下：

1、董事情况

截至本上市公告书签署日，发行人董事的基本情况如下：

姓名	任职	提名人	本届任职期限
程卓	董事长	程卓	2019年10月15日-2022年10月14日
方林	董事	程卓	2019年10月15日-2022年10月14日
窦志	董事	程卓	2019年10月15日-2022年10月14日
李亚敏	董事	程卓	2019年10月15日-2022年10月14日
魏永珍	董事	程卓	2020年4月10日-2022年10月14日
HING WONG	董事	康同投资	2019年10月15日-2022年10月14日
张国铭	独立董事	董事会	2019年11月15日-2022年10月14日
杨维生	独立董事	董事会	2019年11月15日-2022年10月14日
胡刘芬	独立董事	董事会	2019年11月15日-2022年10月14日

2、监事情况

截至本上市公告书签署日，公司监事基本情况如下：

姓名	任职	提名人	本届任职期限
魏美芹	监事会主席	合肥高新投	2019年10月15日-2022年10月14日
刘臻	监事	国投基金	2019年12月25日-2022年10月14日
封宁靓	职工代表监事	职工代表大会	2019年10月15日-2022年10月14日

3、高级管理人员情况

截至本上市公告书签署日，公司高级管理人员基本情况如下：

姓名	任职	本届任职期限
方林	总经理	2019年10月15日-2022年10月14日
魏永珍	董事、财务总监兼董事会秘书	2020年4月10日-2022年10月14日

4、核心技术人员情况

截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员基本情况如下：

姓名	任职
方林	董事、总经理
何少锋	总工程师
CHEN DONG	首席科学家

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况

1、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持股情况

本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下：

姓名	身份	持股数（万股）	持股比例
程卓	董事长	3,678.7490	40.61%
方林	董事、总经理、核心技术人员	140.0000	1.55%
何少锋	核心技术人员	140.0000	1.55%

2、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持股情况

本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过持有亚歌半导体、顶擎电子、合光刻、纳光刻出资额而间接持有公司股份，具体情况如下：

（1）通过控制公司股东间接持有公司表决权的情况

姓名	身份	间接持股平台	持股情况
程卓	董事长	亚歌半导体、合光刻、纳光刻	通过亚歌半导体间接持有芯碁微装294.00万股，通过合光刻间接持有芯碁微装3.35万股，通过纳光刻间接持有芯碁微装95.13万股，对芯碁微装间接持股比例合计为4.33%
方林	董事、总经理、核心技术人员	亚歌半导体	通过亚歌半导体间接持有芯碁微装100.00万股，对芯碁微装间接持股比例为1.10%
李亚敏	董事	合光刻	通过合光刻间接持有芯碁微装3.00万股，对芯碁微装间接持股比例为0.03%
魏永珍	董事、财务总监、董事会秘书	亚歌半导体	通过亚歌半导体间接持有公司8.00万股，对芯碁微装间接持股比例为0.09%
封宁靓	职工代表监事	纳光刻	通过纳光刻间接持有芯碁微装1.00万股，对芯碁微装间接持股比例为0.01%
何少锋	核心技术人员	亚歌半导体	通过亚歌半导体间接持有芯碁微装100.00万股，对芯碁微装间接持股比例为1.10%
CHEN DONG	核心技术人员	亚歌半导体	通过亚歌半导体间接持有芯碁微装140.00万股，对芯碁微装间接持股比例为1.55%
杨国庆	董事长程卓的姐姐之配偶	顶擎电子	通过顶擎电子间接持有芯碁微装270.0690万股，对芯碁微装间接持股比例为2.98%

本次发行后，公司部分高级管理人员和核心员工通过海通资管汇享芯碁微装员工战略配售集合资产管理计划持有本公司股份，海通资管汇享芯碁微装员工战略配售集合资产管理计划的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。海通资管汇享芯碁微装员工战略配售集合资产管理计划的具体情况请参见本节“七、本次发行战略配售情况”。

截至本上市公告书签署日，除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属不存在以其他方式直接或间接持有公司股份的情况。公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押或者冻结的情况。

（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排

1、公司控股股东、实际控制人程卓及其关联股东承诺

（1）控股股东、实际控制人程卓承诺

①自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

②在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%，在离职后6个月内不转让本人直接或者间接持有的发行人股份。

③本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后2年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）；若发行人首次公开发行上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人首次公开发行上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后6个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人直接、间接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长6个月。

（2）程卓控制的亚歌半导体、纳光刻、合光刻承诺

①自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

②本企业所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后2年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本单位减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）；若发行人首次公开发行上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人首次公开发行上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后6个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本企业直接、间接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长6个月。

（3）程卓姐姐之配偶、通过顶擎电子间接持有发行人股份的杨国庆以及申报前6个月内受让杨国庆所持顶擎电子合伙份额的鹏鼎控股承诺

自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、发行人董事（除独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺

（1）除程卓、独立董事之外的董事、高级管理人员

①自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；

②在本人担任发行人董事、或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%，在离职后6个月内不转让本人直接或者间接持有的发行人股份。

③本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后2年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）；若发行人首次公开发行上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人首次公开发行上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后6个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人直接、间接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长6个月。

（2）监事

①自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；

②在本人担任发行人监事期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%，在离职后6个月内不转让本人直接或者间接持有的发行人股份。

（3）核心技术人员

①自发行人股票上市之日起12个月内和离职后6个月，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；

②自直接或间接所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。

（四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况

截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

四、发行人员工股权激励及相关安排情况

截至本上市公告书签署日，除参与本次战略配售的海通资管汇享芯碁微装员工战略配售集合资产管理计划外，发行人不存在正在实施的股权激励及其他制度安排。报告期内，发行人发生的股权激励计划已经实施完毕。

前述已实施完毕的股权激励计划具体情况如下：

公司通过成立亚歌半导体、纳光刻、合光刻三家员工持股平台让激励对象间接持有公司股份。除此之外，2019年9月安徽高新投以股权奖励方式分别向程卓、方林、何少锋转让芯碁有限187.50万元出资额。

1、亚歌半导体基本情况

截至本上市公告书签署日，亚歌半导体持有公司1,260.00万股股份，占公司总股本的13.91%。亚歌半导体的基本情况如下：

项目	基本情况
住所	合肥市高新区天智路20号
统一社会信用代码	91340100343869808L
认缴出资	1,260.00万元
实缴出资	1,260.00万元
企业类型	有限合伙企业
经营范围	半导体产品研发及技术转让；微电子装备、半导体科技产品管理及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015年6月10日
营业期限	自2015年6月10日至2035年6月9日

亚歌半导体为持股平台，未持有其他企业的股权，也未从事其他业务，与公司不存在同业竞争。截至本上市公告书签署日，亚歌半导体的合伙人及出资情况如下：

单位：万元

序号	出资人名称	出资额	出资比例	合伙人性质	在发行人处任职
1	程卓	294.00	23.33%	普通合伙人	董事长
2	陈桂林	240.00	19.05%	有限合伙人	不在发行人处任职，外部投资者
3	CHEN DONG	140.00	11.11%	有限合伙人	首席科学家
4	方林	100.00	7.94%	有限合伙人	董事、总经理
5	何少锋	100.00	7.94%	有限合伙人	总工程师
6	李香滨	52.50	4.17%	有限合伙人	生产总监兼经理
7	董帅	52.50	4.17%	有限合伙人	部门经理
8	赵美云	52.50	4.17%	有限合伙人	部门经理
9	项宗齐	45.00	3.57%	有限合伙人	部门经理
10	魏云飞	28.00	2.22%	有限合伙人	部门副经理
11	严孝年	28.00	2.22%	有限合伙人	部门经理
12	黄明波	28.00	2.22%	有限合伙人	销售经理
13	张玉喆	28.00	2.22%	有限合伙人	FPGA工程师
14	李建兵	27.50	2.18%	有限合伙人	销售总监
15	李建新	15.00	1.19%	有限合伙人	客服总监兼经理
16	沈祥	10.00	0.79%	有限合伙人	市场副总监
17	涂剑波	9.00	0.71%	有限合伙人	销售主管
18	魏永珍	8.00	0.63%	有限合伙人	董事、财务总监、董事会秘书
19	吕慧	2.00	0.16%	有限合伙人	销售经理
合计		1,260.00	100.00%	-	-

亚歌半导体最近一年及一期的财务数据如下：（以下数据未经审计）

单位：万元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年
总资产	1,314.38	1,314.30
净资产	1,309.18	1,309.10
净利润	0.08	-24.72

2、纳光刻基本情况

截至本上市公告书签署日，纳光刻持有公司99.55万股股份，占公司总股本的1.10%。纳光刻的基本情况如下：

项目	基本情况
住所	安徽省合肥市高新区天智路20号璞丽创新广场西面二层201号
统一社会信用代码	91340100MA2TYA0J5J
认缴出资	199.10万元
实缴出资	199.10万元
企业类型	有限合伙企业
经营范围	企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2019年7月19日
营业期限	自2019年7月19日至2034年7月19日

截至本上市公告书签署日，纳光刻的合伙人及出资情况如下：

单位：万元

序号	出资人名称	出资额	出资比例	合伙人性质	在发行人处任职
1	程卓	2.10	1.05%	普通合伙人	董事长
2	杨宇航	12.00	6.03%	有限合伙人	光学工程师
3	张琦	12.00	6.03%	有限合伙人	光学装调工程师
4	卞洪飞	12.00	6.03%	有限合伙人	FPGA工程师
5	朱会敏	12.00	6.03%	有限合伙人	电子工程师
6	刘扬	12.00	6.03%	有限合伙人	硬件工程师
7	刘国藩	12.00	6.03%	有限合伙人	机械工程师
8	曹建国	12.00	6.03%	有限合伙人	部门经理
9	周玉	10.00	5.02%	有限合伙人	部门副经理/电装组长
10	王历先	10.00	5.02%	有限合伙人	机械工程师
11	胡刚	10.00	5.02%	有限合伙人	机械工程师
12	范云瑞	10.00	5.02%	有限合伙人	光学装调工程师
13	杨坤伦	10.00	5.02%	有限合伙人	应用工程师
14	李智	10.00	5.02%	有限合伙人	应用工程师
15	李辉	10.00	5.02%	有限合伙人	精密机械工程师
16	谷慎沛	2.00	1.00%	有限合伙人	销售工程师
17	胡海鲲	2.00	1.00%	有限合伙人	网络运维专员
18	蔡银银	2.00	1.00%	有限合伙人	研发助理
19	王虎廷	2.00	1.00%	有限合伙人	客服工程师（华东）
20	封宁靓	2.00	1.00%	有限合伙人	部门经理、职工代表监事
21	刘万兵	2.00	1.00%	有限合伙人	客服工程师（合肥）
22	孙慧敏	2.00	1.00%	有限合伙人	部门经理
23	李生林	2.00	1.00%	有限合伙人	客服工程师（华南）
24	李娜	2.00	1.00%	有限合伙人	项目申报专员
25	张开宇	2.00	1.00%	有限合伙人	C++软件工程师
26	李亮	2.00	1.00%	有限合伙人	FPGA工程师
27	汪国真	1.00	0.50%	有限合伙人	电子装配技师
28	肖永红	1.00	0.50%	有限合伙人	客服工程师（华南）
29	张瀚	1.00	0.50%	有限合伙人	光学装调工程师
30	陈波	1.00	0.50%	有限合伙人	机械工程师
31	陈永军	1.00	0.50%	有限合伙人	机械装配技师
32	梁霄	1.00	0.50%	有限合伙人	物流主管
33	万海锋	1.00	0.50%	有限合伙人	客服工程师（华南）
34	黄乃娣	1.00	0.50%	有限合伙人	品检工程师
35	邢闪闪	1.00	0.50%	有限合伙人	品检工程师
36	叶成策	1.00	0.50%	有限合伙人	客服工程师（华南）
37	李耀耀	1.00	0.50%	有限合伙人	电子装配技师
38	解小涛	1.00	0.50%	有限合伙人	技术支持工程师
39	曾文武	1.00	0.50%	有限合伙人	客服工程师（华南）
40	李一根	1.00	0.50%	有限合伙人	客服工程师（合肥）
41	朱小林	1.00	0.50%	有限合伙人	采购专员
42	顾承利	1.00	0.50%	有限合伙人	电子装配技师
43	范红燕	1.00	0.50%	有限合伙人	主办会计
44	汪辉	1.00	0.50%	有限合伙人	客服工程师（华南）
45	彭珏	1.00	0.50%	有限合伙人	客服工程师（华南）
46	杨晓林	1.00	0.50%	有限合伙人	品检工程师
47	吴飞	1.00	0.50%	有限合伙人	销售工程师
合计		199.10	100.00%	-	-

3、合光刻基本情况

截至本上市公告书签署日，合光刻持有公司82.45万股股份，占公司总股本的0.91%。合光刻的基本情况如下：

项目	基本情况
住所	安徽省合肥市高新区天智路20号璞丽创新广场西面二层201号
统一社会信用代码	91340100MA2TYAADXG
认缴出资	164.90万元
实缴出资	164.90万元
企业类型	有限合伙企业
经营范围	企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2019年7月26日
营业期限	自2019年7月26日至2034年7月26日

（下转A20版）